

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-06-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	光大证券、东北证券、中金证券、招商证券、广发证券、西南证券、广发证券资管、中银证券资管、中泰自营、中信建投资管、光大证券资管、光大永明资管、国泰君安资管、南方基金、信达澳银基金、华宝基金、华夏基金、博时基金、华商基金、睿远基金、银华基金、九泰基金、广发基金、平安基金、华富基金、诺德基金、长安基金、鹏华基金、兴合基金、东方基金、西部利得基金、招银理财、宁银理财、东海自营、德邦自营、幻方量化、神农投资、韶夏投资、源乐晟资产、海螺创投、永诚资产、五地投资、雷石私募基金、CPE 源峰、泰康资产、明达资产、恒力投资、呈瑞投资、尚近投资、复星集团、多鑫投资、联合利业、上海智尔投资
时间	2022年6月13日——15日
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、王渝、肖晓月

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、公司简介

公司成立于 1993 年，持续深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户升级。自 2018 年起公司开始步入产能扩张阶段，目前前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。

2022 年第一季度，公司实现营业收入 127,247.69 万元、同比增长 18.82%，整体收入规模保持增长态势，归母净利润 20,108.33 万元、同比增长 98.28%，扣非净利润 12,109.08 万元、同比增长 10.56%。2022 年制造业面临需求端通缩叠加成本端通胀压力，公司将继续保持战略定力，推动广州兴科 IC 封装基板项目的投资扩产及广州 FCBGA 封装基板项目、珠海 FCBGA 封装基板项目的投资建设，并积极提升自身的能力以应对宏观经济层面的不确定性和行业层面的竞争压力。

二、IC 封装基板规划介绍

BT 载板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已实现满产满销，整体良率保持在 96%左右；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科，由全资子公司珠海兴科实施）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，第一条产线（1.5 万平方米/月）目前进展顺利。

FCBGA 载板：广州 FCBGA 封装基板项目已启动建设前期准备工作，同步启动设备采购工作，计划 2023 年底前后建成产线、进入试产阶段。

珠海 FCBGA 封装基板项目目前正常推进中。

三、珠海和广州同时启动 FCBGA 封装基板项目投资的原因，是否有资金压力

全球 FCBGA 封装基板供应商有限，供应严重不足，且主要支持海外客户，无法满足国内下游客户的需要，国内市场需求旺盛。目前公司 FCBGA 封装基板团队已到位，利用珠海现成厂房进行项目建设，同步启动政府主管部门的审批备案，预计能较广州项目提前 1 年投产，将为广州项目积累试产经验和储备客户资源，同时投产后能降低 FCBGA 封装基板项目人工成本对利润的拖累，广州项目建设投产后，预计珠海项目已实现达

产，实现投产、达产无缝衔接。

珠海和广州 FCBGA 封装基板项目将边建设边投产，非一次性投入，公司目前主要通过银行类金融机构进行融资，与多家银行（含政策性银行）保持稳定合作关系，信用良好，融资成本较低。

四、IC 封装基板下游应用及公司客户情况介绍

存储类载板是 BT 载板领域最大的下游市场，也是公司目前主要目标市场。公司目前 IC 封装基板以 BT 类载板为主，FCBGA 封装基板项目尚未投产，下游占比为：存储类占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关占比约 1/3，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况为：大陆客户占比约 2/3，中国台湾客户和韩系客户合计占比约 1/3，下游大陆厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

五、IC 封装基板行业竞争格局预判

2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 144 亿美金，同比增速超 40%，IC 封装基板已超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产必将带动 IC 封装基板和半导体测试板行业需求的增长，行业赛道好，玩家少。

公司在封装基板领域积累了丰富的经验(2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利)，且已通过三星认证，从侧面说明了公司的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可。

BT 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家。行业新进入者需要组建经验丰富的团队，在当前行业高景气度下团队组建成本较高，核心设备交付周期延长(18~24 个月)，且从组建团队、拿地建厂、装修调试到产能爬坡，完成大客户认证，保守估计至少需要 2~3 年时间，因此预计未来 2~3 年国内产业链供需格局预期仍乐观。

FCBGA 封装基板目前国内暂无量产企业，公司已完成团队组建，并同步启动设备采购和政府主管部门的审批备案，开始投资建设 FCBGA 封装基板项目。

六、下游应用领域未来景气度预判

从产品结构看，呈现结构分化的增长趋势：高端产品的景气度较高，中低端产品随着产品更新迭代和技术升级，需求会相对弱一些。根据 Prismark 的预测，未来五年增速最快的领域是 IC 封装基板和多层板领域。从应用领域看，服务器领域是今年景气度最高的下游行业，对宜兴硅谷有较大贡献；通信行业的增长情况取决于 5G 推动的进度，宜兴硅谷已突破通信行业大客户的 5G 认证，未来形势向好；安防、工控、轨道交通等行业的增长相对平稳；医疗方面目前虽因疫情影响市场景气度较好，但从长期看表现平稳；汽车电子方面，总量没有大的增长，结构会从传统汽车转向新能源汽车。受 5G、AI、大数据、物联网、智能驾驶等领域快速发展的拉动，芯片需求量持续增长，高端芯片的紧缺程度持续提升，作为核心材料的 IC 封装基板未来几年的增速会显著高于 HDI 板、多层板、纸基板、双面板和 FPC 等产品。

七、定增项目的计划

公司定增项目已经接触了不少有认购意向的投资者。公司将于 2022 年 6 月 16 日完成 2021 年年度权益分派，根据相关法规规定，利润分配实施完毕前不得发行，因此预计将在 2022 年 6 月 16 日起至 2022 年 10 月 19 日（定增批文有效期届满之日）间视情况择机发行。

八、公司未来的战略方向

基于对产业趋势的判断、客户需求及公司自身技术、产品升级需要，公司未来的重点工作是推动广州兴科 IC 封装基板项目的投资扩产及广州 FCBGA 封装基板、珠海 FCBGA 封装基板项目的投资建设。传统 PCB 业务也是公司的主要收入和利润贡献来源之一，未来主要通过提升研发能力、数字化改造、加强与大客户的合作深度等方面来提升传统 PCB 业务的竞争力，实现效率提升和平稳增长。长期来看，随着公司 IC 封装基板业务的逐步投产和达产，未来半导体业务的收入和利润占比将会逐步提升。

附件清单	无
日期	2022 年 6 月 13 日——15 日